

貼合装置

多様な【貼る】のご用途に対応

ラミネーション装置 (フラットパネル貼合装置)

液晶ディスプレイ、電子ペーパー、タッチパネルなど各種貼合に対応



1. エアバブル・パーティクルフリー、テンションフリー

- ・基板（製品）へのホコリ、エアバブルの混入を最大限に低減
- ・薄い粘着フィルム等をテンションなしで貼り付け、カールを発生させない

2. 高精度貼り合わせ $\pm 15\mu\text{m}$ が可能！

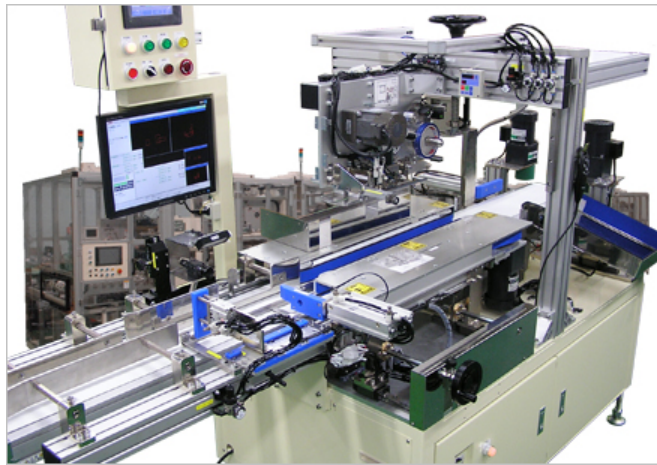
メカニカルアライメントはもちろん、カメラ等も利用して安定した貼り付けを実現

3. カスタマイズマシン

お客様の仕様をとことん追求する装置製作を基本としています。

テーピング装置

1層、2層、3層… 各種テープの自動貼付に最適な装置をご提案



マスキングテープ、スポンジテープ、クラフトテープ、両面テープ、OCA、絶縁テープ、導電テープ、ポリイミドテープ等、貼りたい長さで、貼りたい場所へ気泡の噛み込みなしにテープを貼りつける装置をご提案。テープの長さの設定をすることで、無駄を抑えてコストカットを実現。

ラベリング装置



一般的な紙・プラスチックのラベルのみならず、RFIDタグ・半導体のチップ・アルミ箔・有機ELディスプレイのデシカント等、“ラベル”の自動貼付装置をご提案。

商品名

貼合装置

メーカー

株式会社サンテック

分類

設備・装置

データは規格値ではありません。また記載内容は、仕様変更などのため断りなく変更することがあります。